

19. August 2024

Am Dienstag fällt der Startschuss zum Bau des ESMC-Chipwerks

Bundeskanzler Scholz und EU-Kommissionschefin von der Leyen kommen zum Spatenstich nach Dresden.

Von Nora Miethke

Dresden. Nur ein Jahr nach der Ankündigung des weltgrößten Chipauftragsfertigers TSMC, in Dresden sein erstes europäisches Halbleiterwerk zu bauen, wird am Dienstag der erste Spatenstich gesetzt.

Zu der offiziellen Zeremonie werden 150 bis 200 Gäste erwartet. Neben TSMC-Vorstandschef C.C.Weï werden die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) anreisen und eine Rede halten. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) wird ein Grußwort sprechen, begleitet von fünf Ministern aus seinem Kabinett und weiteren Beamten.

Das zahlreiche Erscheinen ist nicht verwunderlich, da die Ansiedlung von TSMC eine der größten Einzelinvestitionen in der Geschichte des Freistaats ist. Rund zehn Milliarden Euro fließen in das Projekt, knapp die Hälfte soll vom deutschen Staat kommen. Möglich wird diese hohe Förderung durch den europäischen Chips Act. Mit dem Gesetz werden die strengen Beihilferegeln für Subventionen gelockert.

Der taiwanesischer Halbleiterkonzern hat mit den Herstellern Bosch, Infineon und NXP für den Bau und Betrieb der Fabrik das Gemeinschaftsunternehmen European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) gegründet, an dem die Partner je zehn Prozent der Anteile halten. Im Jahr 2027 soll die Serienproduktion beginnen. ESMC legt das Hauptaugenmerk auf Chips für Autos, sogenannte Automotive-Halbleiter, mit Strukturweiten von 28, 22, 16 und 12 Nanometern. Dazu gehören Mikrocontroller für Motorsteuerungen, Infotainment- und Fahrerassistenzsysteme sowie Radarsensoren.

In der Chipfabrik, intern Fab 24 genannt, sollen 2.000 Arbeitsplätze entstehen. Die ersten Stellen für Ingenieure sind bereits auf der Plattform LinkedIn ausgeschrieben worden. Christian Koitzsch, seit Januar 2024 Präsident von ESMC, kündigt an, dass die duale Ausbildung schon im kommenden Jahr starten soll.

„Wir planen mit einer vollen Klasse von Mechatronikern und einer vollen Klasse von Mikrotechnologen“, sagt Koitzsch im ersten Interview mit der SZ. Er hat bislang ein Team von 20 Personen aufgebaut, die Hälfte davon sind entsendete Kollegen aus Taiwan.

Vor wenigen Tagen zurückgekehrt sind die ersten 30 Studierenden sächsischer Hochschulen von einem sechsmonatigen Studienaufenthalt in Taipeh und im Trainingszentrum von TSMC in Taichung. „Ich habe mich willkommen gefühlt, sie haben alle Anstrengungen unternommen, uns viel beizubringen“, berichtet Jannis Kaliske, Student an der TU Dresden. Aktuell sucht TSMC die nächsten 60 Austauschstudenten für das kommende Jahr aus.

Seiten 2 und 3